

2025 法人說明會

總經理 黃道景 2025.03.19

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



公司簡介

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

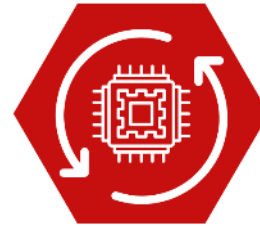


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

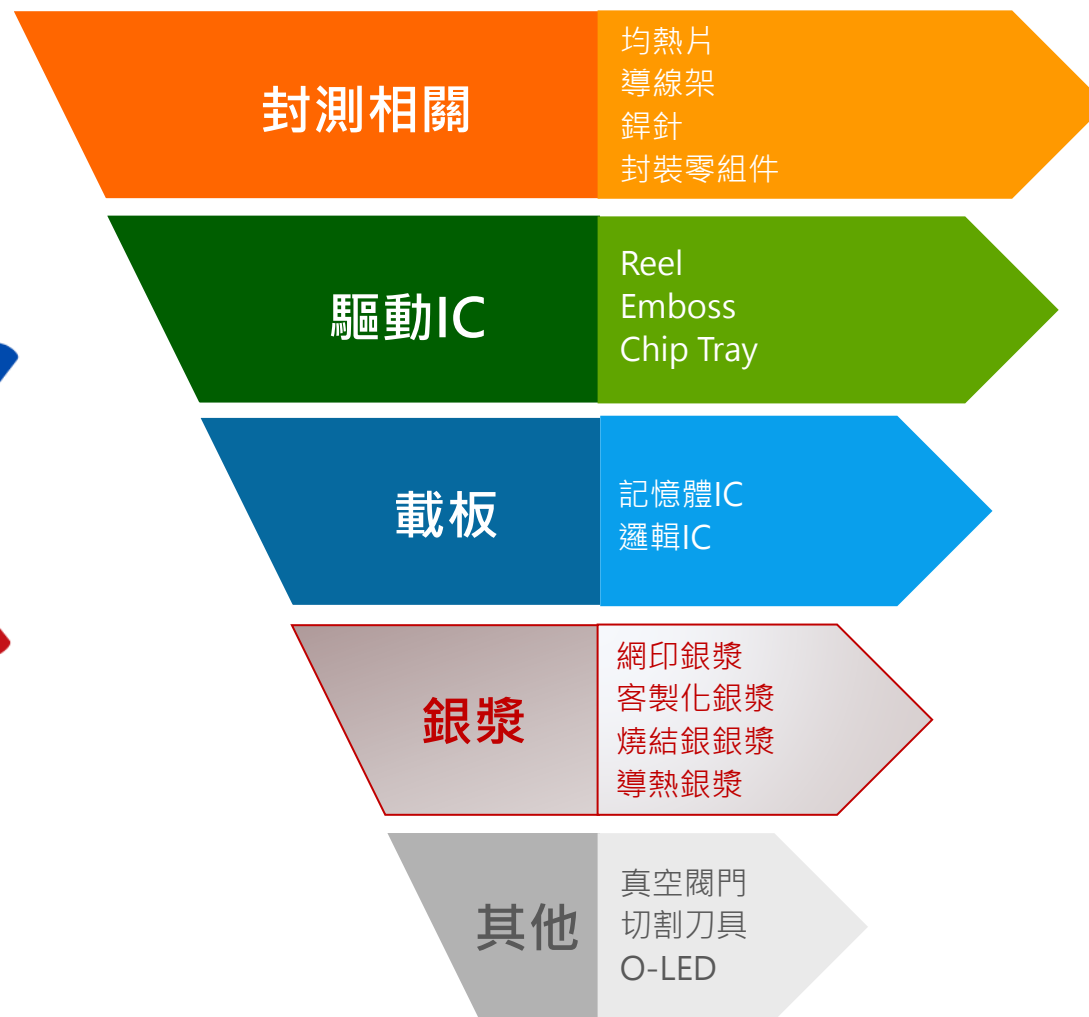
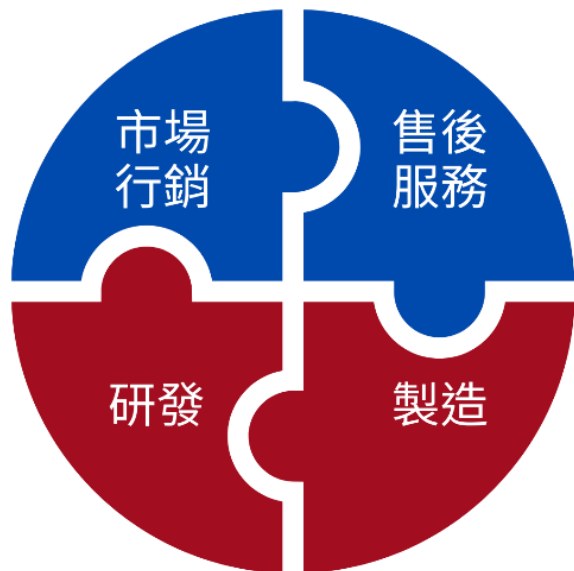
半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿

代理商 ➡ 整合型材料供應商





營運報告

(2024 年度)

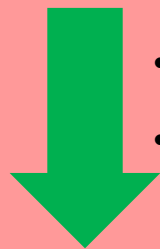
2024年度 業務概要

- 2024營收年成長 18%，營業毛利年增11%。稅後淨利年增15%，EPS年增13% 達2.39元。
- 三大主力產品之封測相關產品營收年增28%並創歷年新高，驅動IC相關產品年增13%，半導體載板年增8%。
- 營業外收入主要係加值型轉投資策略調整且中國市場回溫，加值型轉投資收益年增67%。

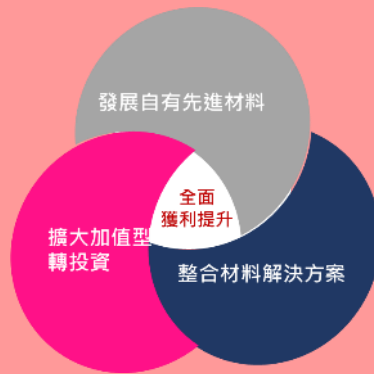
2024市場



整合型材料供應商優勢



- 消費產品需求下降
- 車用需求平緩



- AI晶片與高階封裝需求強勁
- 中國大尺寸面板需求上升
- 電子標籤與車用面板發酵



綜合損益表

整體營收及毛利金額均呈雙位數成長

2024年

(NT\$仟元)	2022	2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	2024	2024年		
								Q4	累計全年	
								QoQ	YoY	YoY
營業收入	1,060,398	976,397	238,074	301,397	304,539	309,476	1,153,486	2%	26%	18%
營業毛利	310,949	255,756	63,037	73,889	79,153	68,847	284,926	-13%	8%	11%
毛利率	29%	26%	26%	25%	26%	22%	25%	-15%	-15%	-6%
營業淨利	124,057	75,279	13,241	21,977	28,235	14,840	78,293	-47%	-31%	4%
營業外收(支)	110,067	36,565	23,801	14,426	(717)	27,675	65,185	3960%	245%	78%
稅前淨利	234,124	111,844	37,042	36,403	27,518	42,515	143,478	54%	967%	28%
本期淨利	195,976	93,545	31,079	33,013	7,273	36,087	107,452	396%	1278%	15%
淨利率	18%	10%	13%	11%	2%	12%	9%			
EPS (NT\$) 註:	4.90	2.12	0.69	0.73	0.16	0.81	2.39	406%	1250%	13%

資產負債表

NT\$仟元	2021	2022	2023	2024
資產				
現金及約當現金	279,765	327,431	398,797	333,159
應收帳款	509,553	532,247	443,432	550,367
存貨	66,764	60,048	67,008	60,611
轉投資相關	205,830	257,247	263,434	252,910
不動產、廠房及設備	228,528	226,154	223,341	286,419
其他資產	23,817	26,539	34,288	29,040
資產總計	1,314,257	1,429,666	1,430,300	1,512,506
負債				
短期借款	126,429	150,000	-	-
應付帳款	265,051	227,968	233,559	315,611
其他負債	115,613	131,435	110,272	122,610
負債總計	507,093	509,403	343,831	438,221
權益總計	807,164	920,263	1,086,469	1,074,285
淨值 (NT\$元)	20.64	23.53	24.63	23.87

歷年營收/接單金額

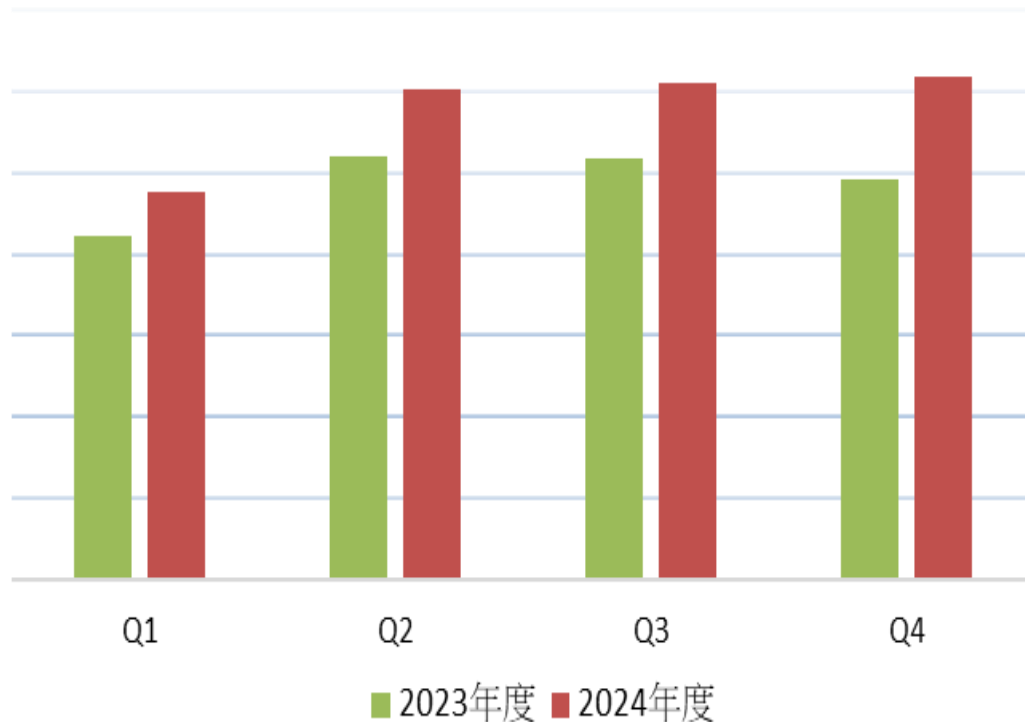
2013-2024 CAGR(複合成長率)

營收：3.3% 接單金額：8.4%

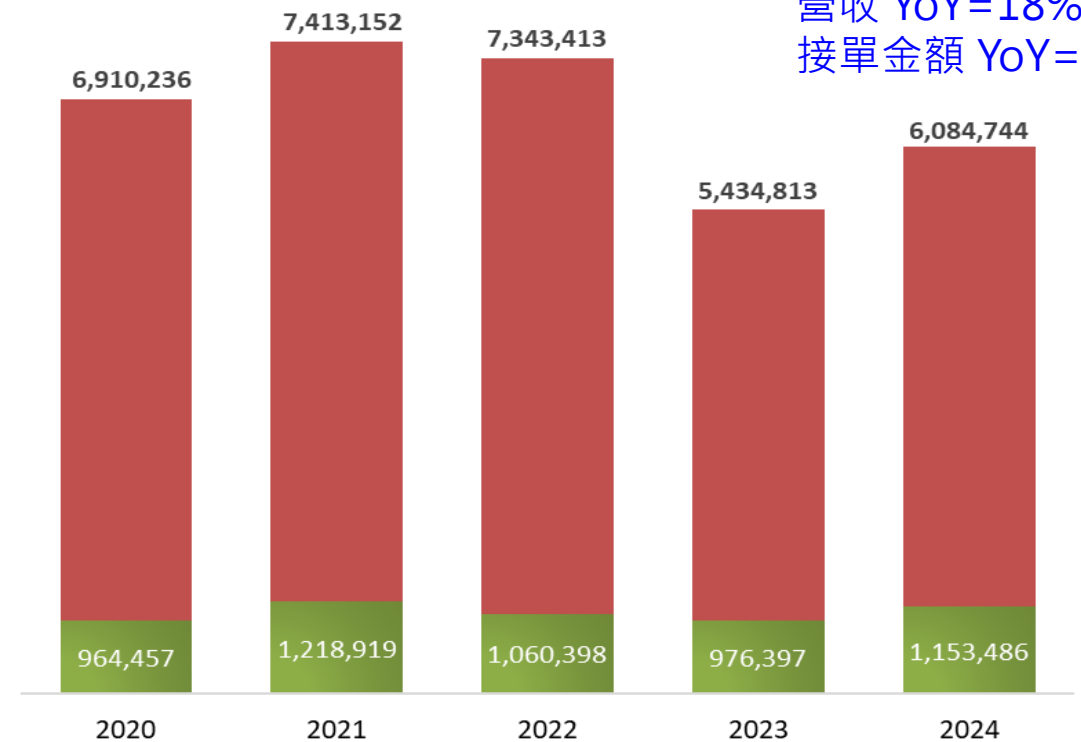
單位：仟元

■ 營收 ■ 接單金額

每季營收



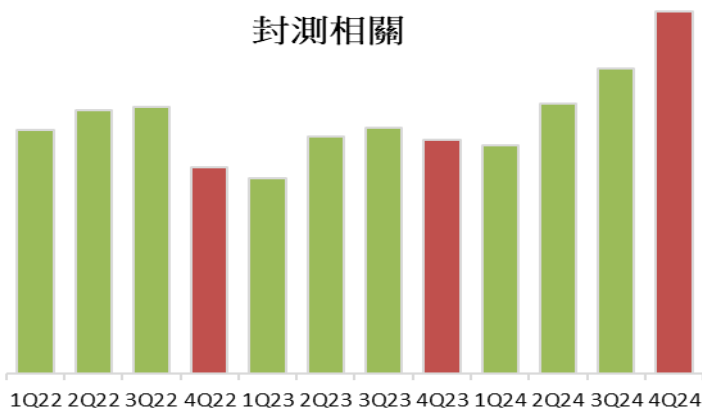
營收 YoY=18%
接單金額 YoY=12%



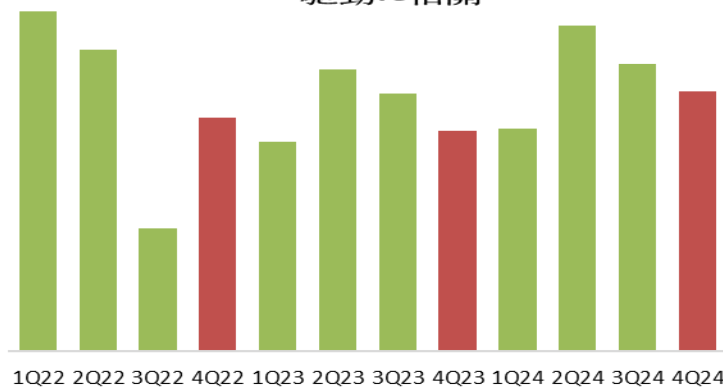
說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)
接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

各領域別營收

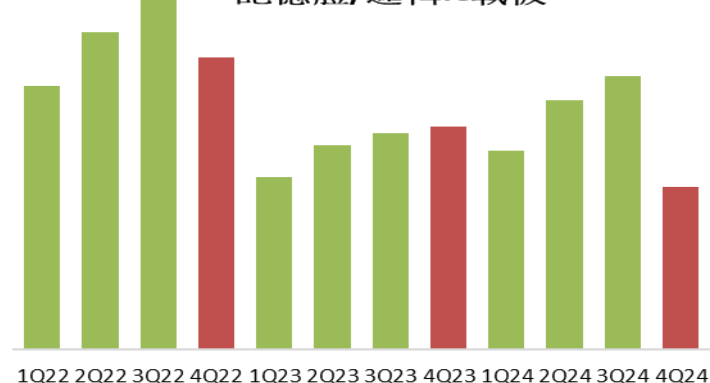
封測相關



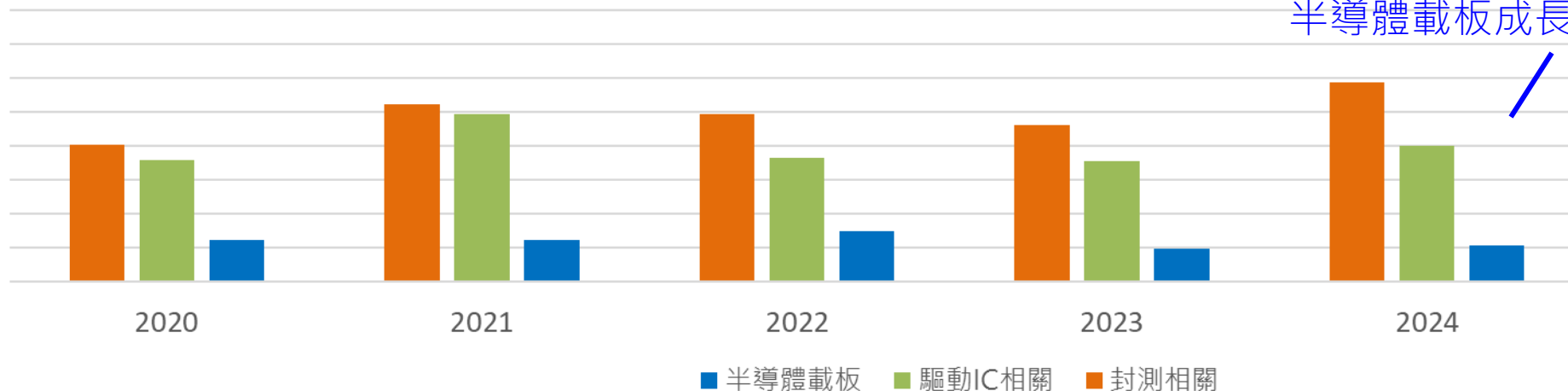
驅動IC相關



記憶體/邏輯IC載板

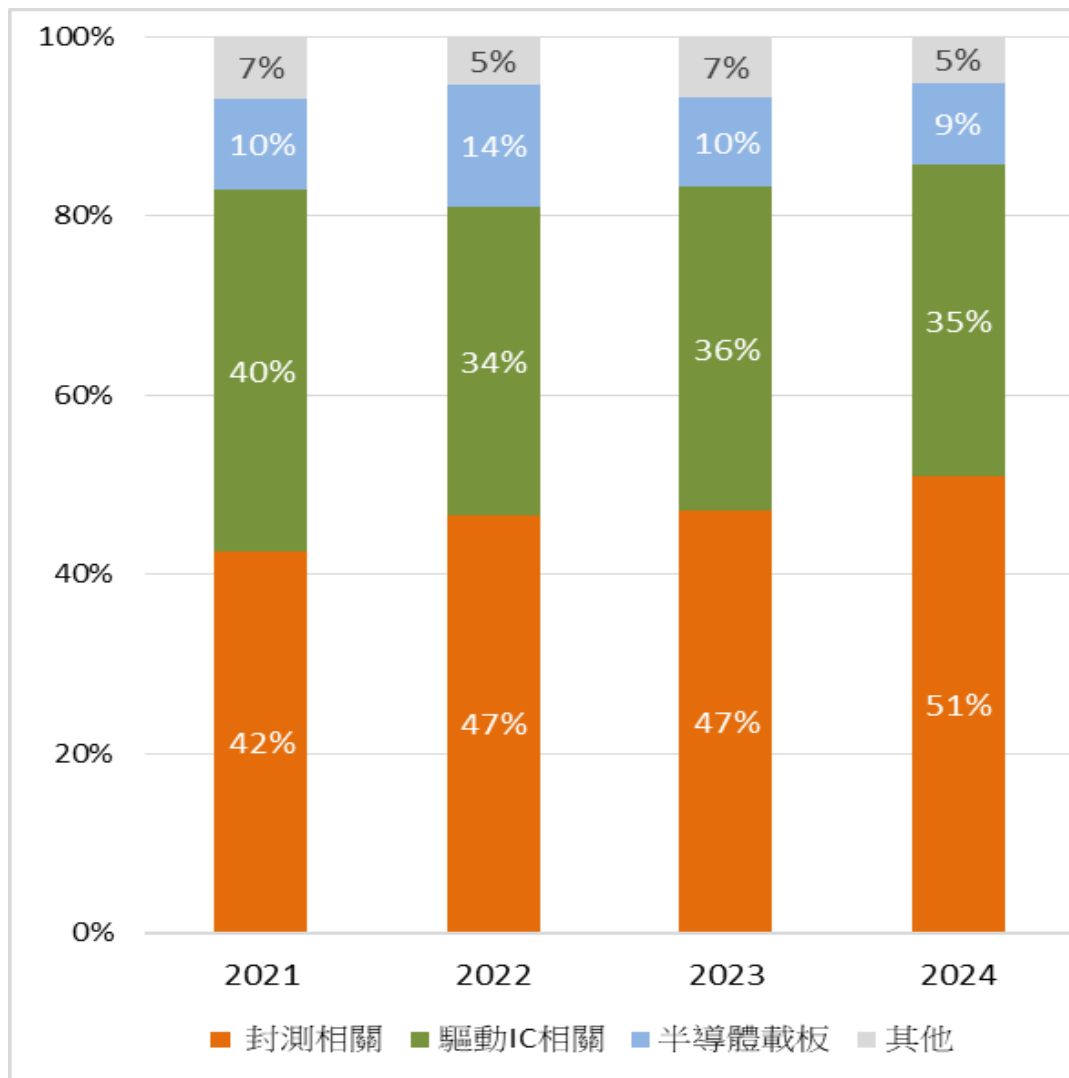


三大主力產品



三大領域產品均成長
封測相關成長28%且創歷年新高
驅動IC相關成長13%
半導體載板成長8%

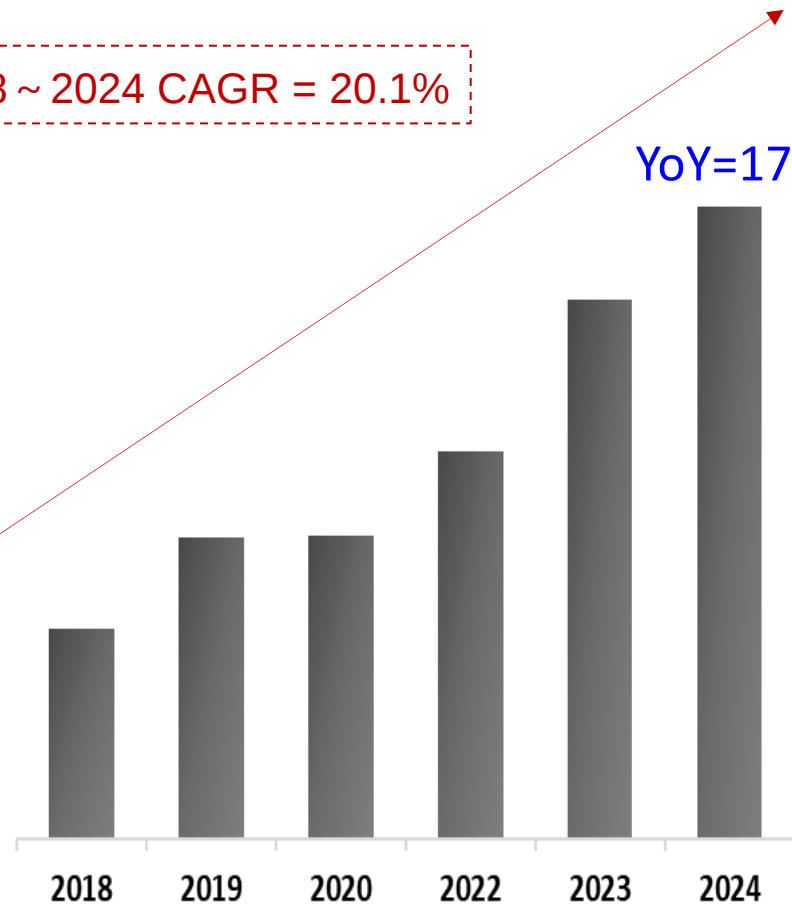
產品別營收佔比



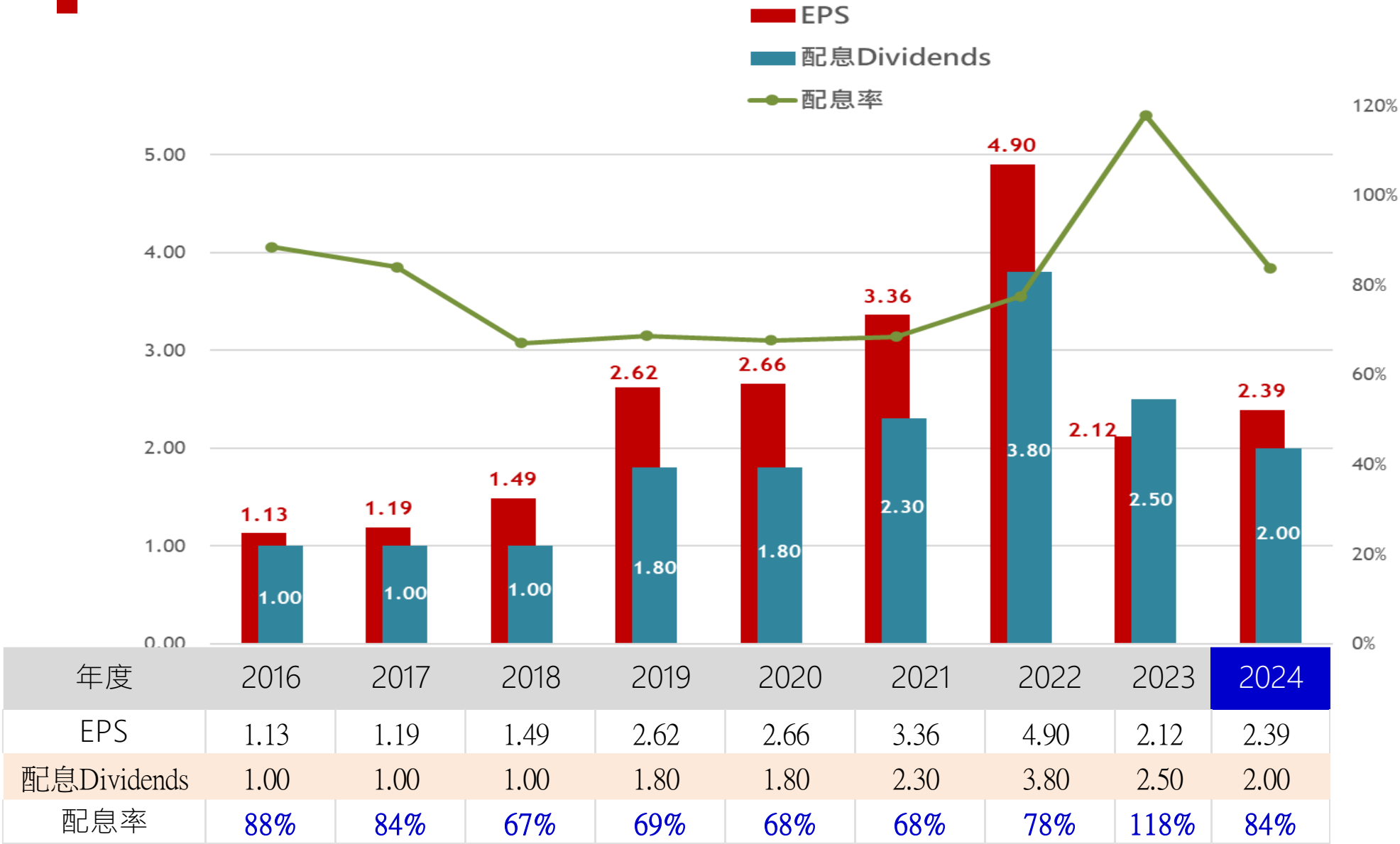
銀漿營收成長

2018 ~ 2024 CAGR = 20.1%

YoY=17%

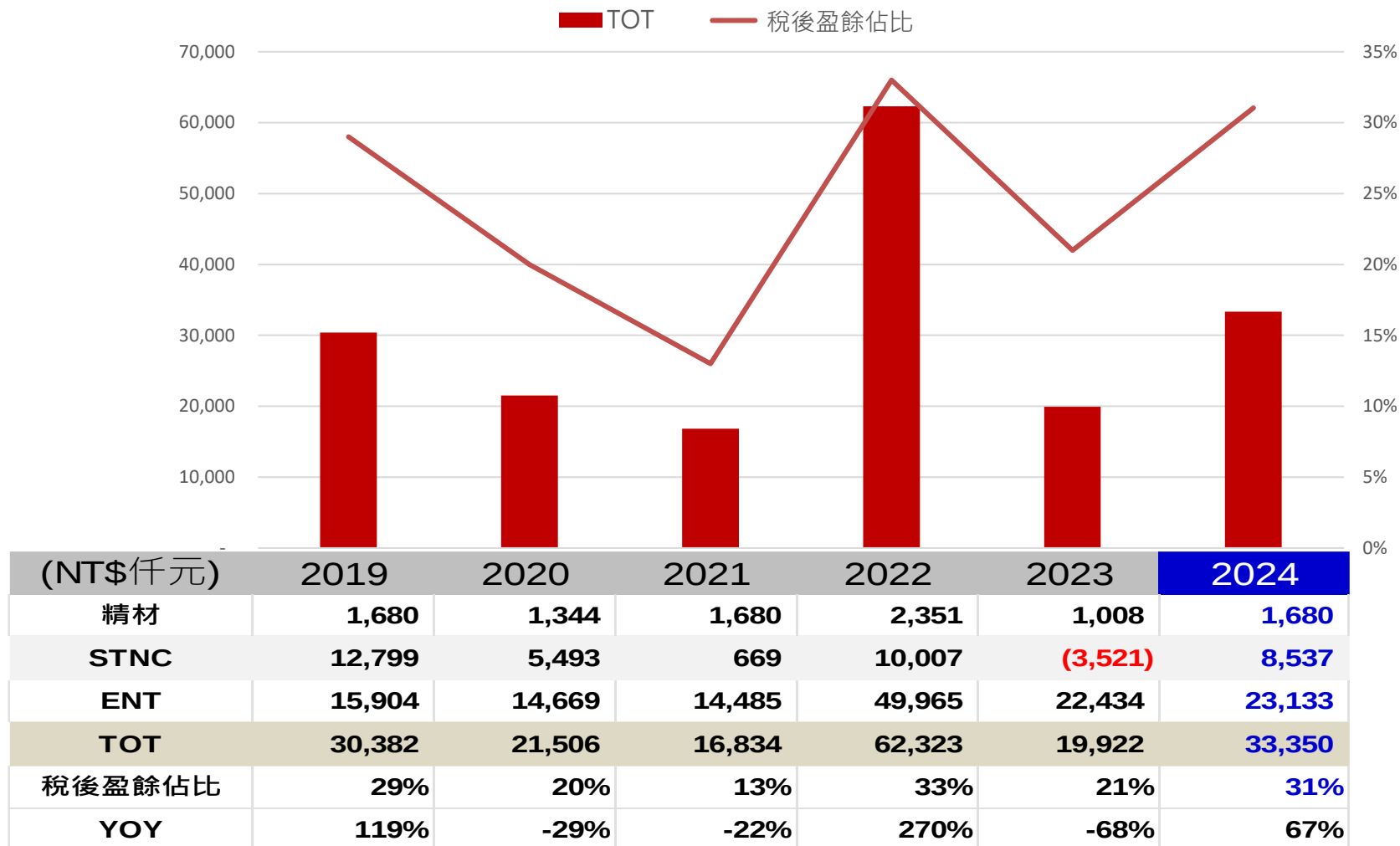


歷年配息率



三大加值型轉投資長期穩定貢獻獲利

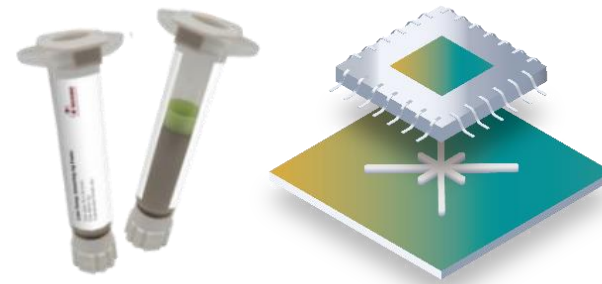
策略調整、中國市場回溫→轉投資收益年增67%





營運展望

(2025 年度)



自有銀漿研發

客製化銀漿

IOT



1. 快速固化
2. 高導電性
3. 低功率損耗

車用電子



1. 高附著強度
2. 高信賴性

燒結銀膠

IGBT



1. 適用大尺寸
($> 10 \times 10$ MM) 晶片
2. 超高散熱性
(> 200 W/MK)

高功率LED



1. 超高散熱性
(> 200 W/MK)
2. 高信賴性
3. 175°C 燒結銀

高導熱銀膠

MOSFET



1. 高導熱性
2. 高韌性
3. 高信賴性

策略一：發展自有先進材料

燒結銀成長策略

聚焦、突破、成長三部曲

1. 選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場



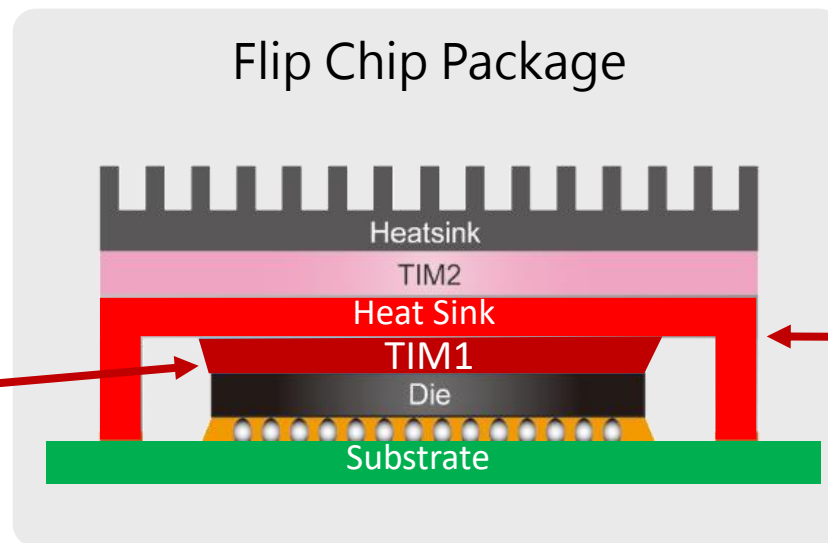
2. 聚焦優勢技術(固化技術)，發現下一個價值型產品



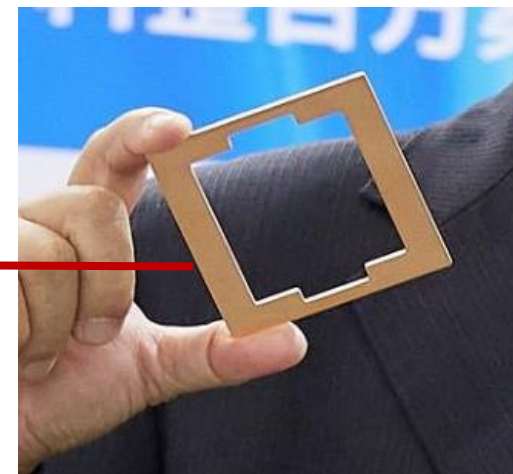
IC散熱解決方案

因應AI新應用、高階封裝需求帶動散熱相關市場的成長

銀漿



均熱片



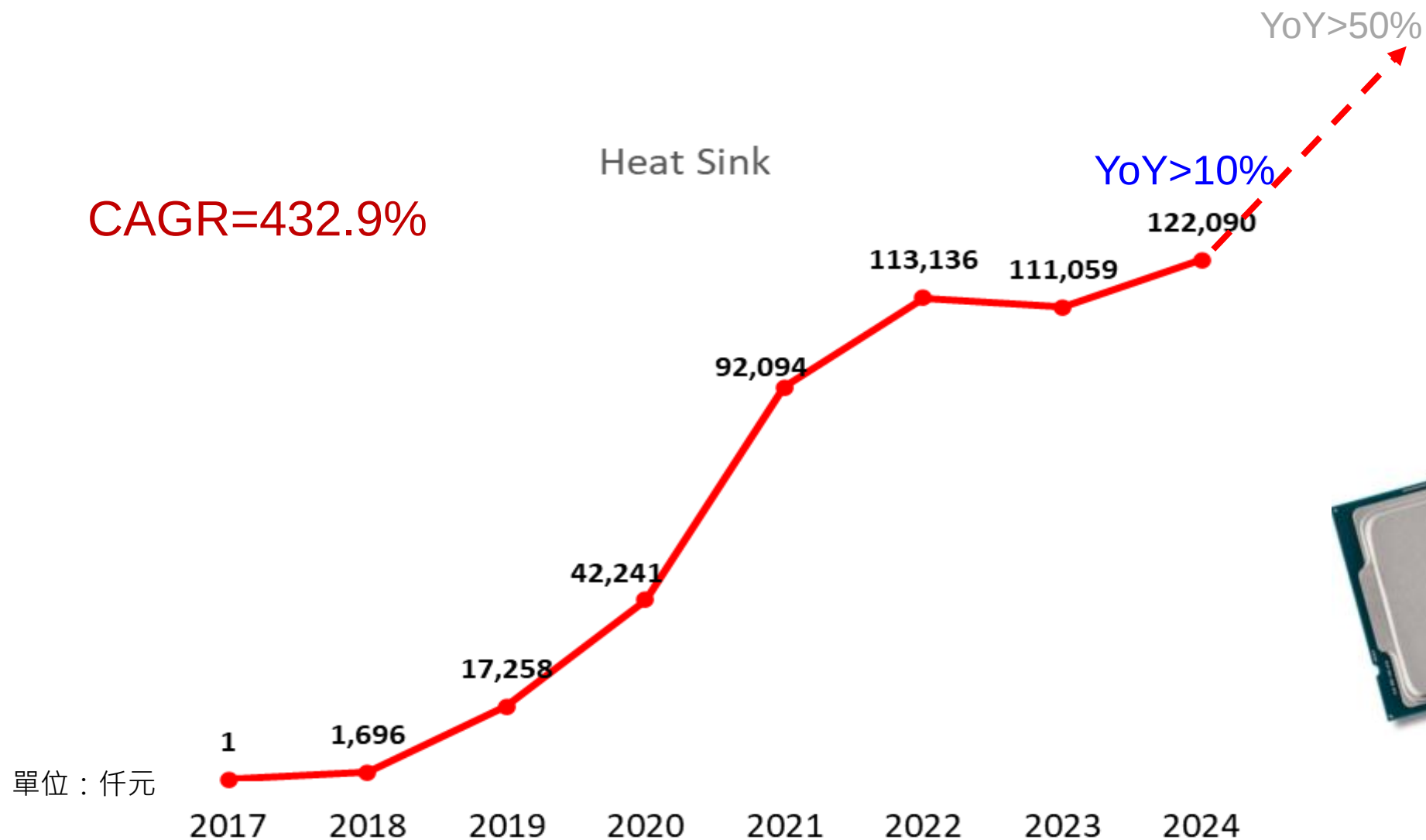
策略二：整合材料解決方案

均熱片成長策略

垂直整合技術



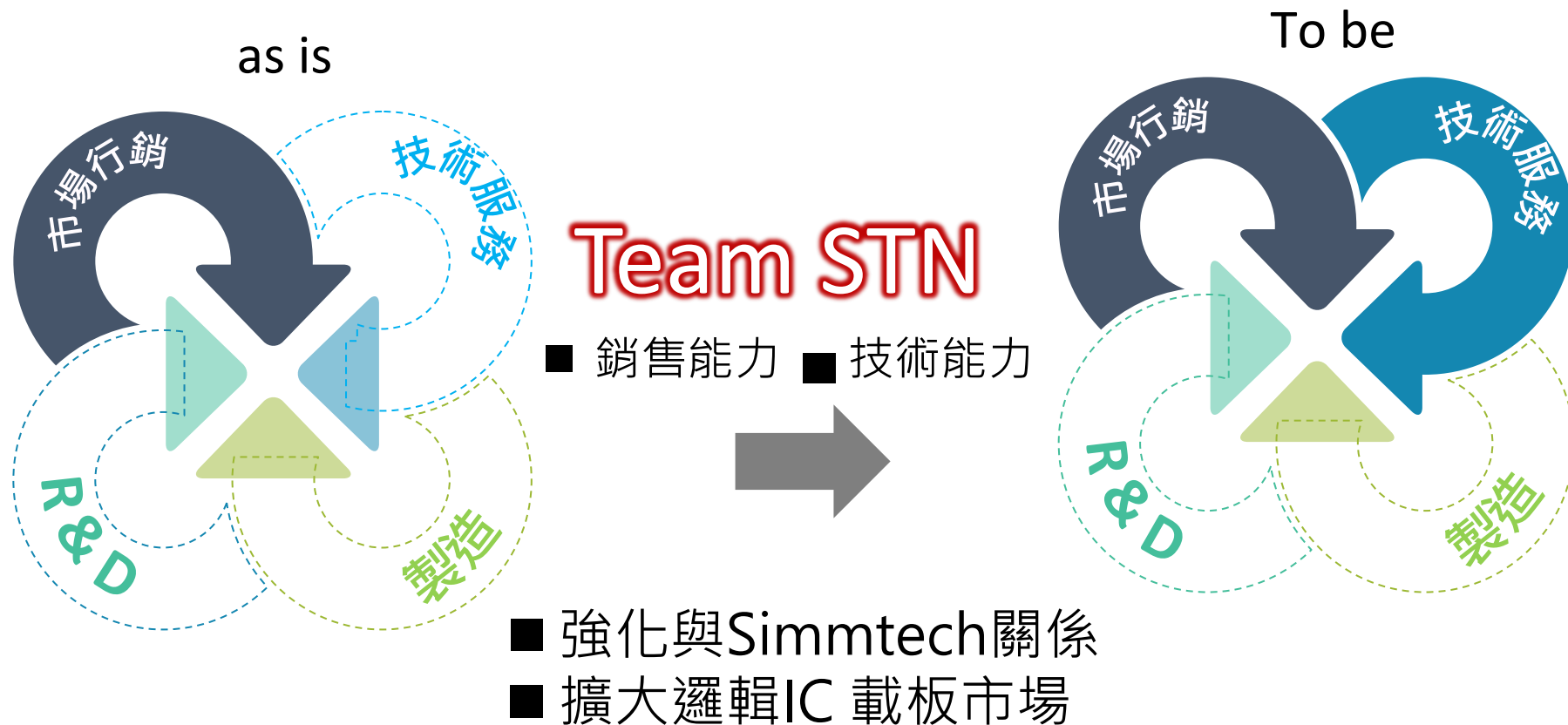
均熱片歷年營收



策略二：整合材料解決方案

載板成長策略

垂直整合服務



策略二：整合材料解決方案

- 驅動IC相關、封測相關及各項新代理產品，除掌握終端需求回溫、AI大放異彩之商機，也持續擴展電子標籤、車用面板領域及AR/VR應用新需求，將2025年業績再往上推升。
- 新產品:鎖定先進封裝技術，持續開發新代理產品線。



- 一. 2024年營收年成長 18%，營業毛利年增11%。稅後淨利年增15%，EPS年增13% 達2.39元。表現優於預期。
- 二. 2025年隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續攀升，半導體產業有望迎來新的榮景，刺激高階封裝及散熱材料需求，帶動利機各主力產品成長。尤其封測相關產品市場需求暢旺，全年有望創新高，並帶動利機全年營收也創新高。
- 三. 自有研發銀漿產品—對於IC散熱市場與自有技術深具信心。將選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場，聚焦具優勢之高散熱、高導熱及快速固化技術，開發價值型產品。
- 四. 新產品—鎖定先進封裝技術，持續開發新代理產品線。

THANK YOU

